

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 3 部門第 3 区分
【発行日】令和 6 年 9 月 17 日(2024.9.17)

【公開番号】特開 2024-91963(P2024-91963A)
【公開日】令和 6 年 7 月 5 日(2024.7.5)
【年通号数】公開公報(特許)2024-125
【出願番号】特願 2024-72934(P2024-72934)
【国際特許分類】

C 0 9 J 2 0 1 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 9 J 1 1 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 9 J 1 1 / 0 8 (2 0 0 6 . 0 1)
C 0 9 J 1 6 1 / 0 4 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【F I】
C 0 9 J 2 0 1 / 0 0
C 0 9 J 1 1 / 0 4
C 0 9 J 1 1 / 0 8
C 0 9 J 1 6 1 / 0 4

【手続補正書】
【提出日】令和 6 年 9 月 6 日(2024.9.6)

20

【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

熱硬化性樹脂と、硬化剤と、エラストマーと、無機フィラーとを含有し、
前記熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂であり、

30

前記エポキシ樹脂がビスフェノール F 型エポキシ樹脂を含み、

前記硬化剤が脂環式環を有するフェノール樹脂を含み、

前記エラストマーの含有量が、前記熱硬化性樹脂 100 質量部に対して、10～80 質量部である、
接着剤組成物(ただし、1 分子内にフェノール性水酸基を 1 つ有するメチロール化合物を含有する場合、又は、グリシジル基及びエチレン性不飽和基を有する化合物並びに光開始剤を含有する場合を除く。)。

【請求項 2】

前記エラストマーがアクリル樹脂である、請求項 1 に記載の接着剤組成物。

【請求項 3】

無機フィラーがシリカである、請求項 1 又は 2 に記載の接着剤組成物。

40

【請求項 4】

前記無機フィラーの含有量が、接着剤組成物全量を基準として、25 質量%以上である、
請求項 1～3 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。

【請求項 5】

前記熱硬化性樹脂、前記硬化剤、前記エラストマー、及び前記無機フィラーの合計の含有量が、
接着剤組成物全量を基準として、95 質量%以上である、請求項 1～4 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。

【請求項 6】

硬化促進剤をさらに含有する、請求項 1～5 のいずれか一項に記載の接着剤組成物。

【請求項 7】

50

請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の接着剤組成物をフィルム状に形成してなる、フィルム状接着剤。

【請求項 8】

基材と、

前記基材上に設けられた、請求項 7 に記載のフィルム状接着剤と、
を備える、接着シート。

【請求項 9】

前記基材がダイシングテープである、請求項 8 に記載の接着シート。

【請求項 10】

前記フィルム状接着剤の前記基材とは反対側の面に積層された保護フィルムをさらに備える、請求項 8 又は 9 に記載の接着シート。

10

【請求項 11】

基板上に第 1 のワイヤを介して第 1 の半導体素子を電氣的に接続するワイヤボンディング工程と、

第 2 の半導体素子の片面に、請求項 7 に記載のフィルム状接着剤を貼付するラミネート工程と、

前記フィルム状接着剤が貼付された第 2 の半導体素子を、前記フィルム状接着剤を介して圧着することで、前記第 1 のワイヤの少なくとも一部を前記フィルム状接着剤に埋め込むダイボンド工程と、

を備える、半導体装置の製造方法。

20

30

40

50